



創 變 智 造 新 未 來

台達 IR 孔洞檢查機

WIR 3010 2



台達 IR 孔洞檢查機

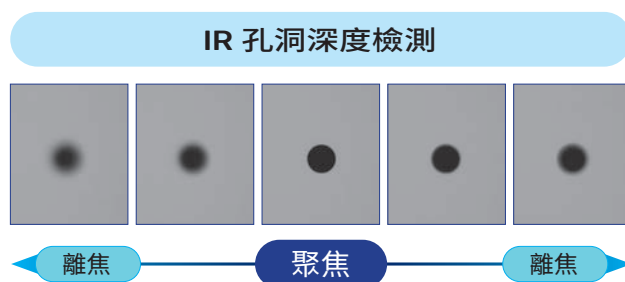
WIR 3010 2



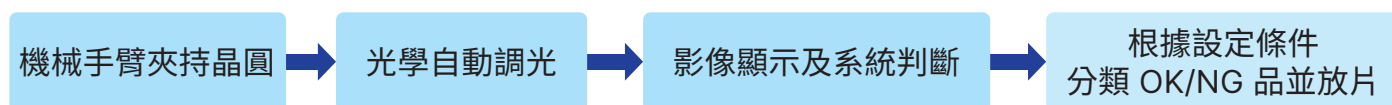
功能與特色

非接觸與非破壞式光學檢測，並具自動調光機制，可根據不同厚度、阻值進行自動光學調適，實時顯示檢測影像

- 高速產能，每小時可檢測 60~160 pcs
- 依據晶圓特性分類，自動調光優化調試參數
- 缺陷深度面掃描 (Area Scan)，定義缺陷大小
- 瑕疵缺陷 AI 複判系統



動作流程



標準規格

型號	WIR 3010 2
機台尺寸	約 1,750 (L) × 2,860 (W) × 2,000 (H) mm
重量	約 2,000 kg
產品尺寸	12inch
加工產品數 / 次	1pcs
產能	60 ~ 160 pcs/hr
I/O 介面	有
通訊介面	Ethernet
控制器	PC-Based
操作介面	一般螢幕
氣源氣壓	0.5 ~ 0.8 MPa
電源電壓	220 V _{AC} 50/60 Hz
產品進出方式	卡匣

* 台達保有更改規格之權力，恕不另行通知

應用領域



半導體晶圓
IR 孔洞缺陷檢測



台達電子工業股份有限公司
機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

* 本型錄內容若有變更，恕不另行通知